

「SEMICON Japan / APCS 2023」 出展のご案内

拝 啓

平素は格別のお引き立てをいただき厚く御礼申し上げます。

芝浦メカトロニクスグループは、12月13日(水)～15日(金)、東京ビッグサイトで開催される『SEMICON Japan / APCS (Advanced Packaging and Chiplet Summit) 2023』に出展いたします。

是非この機会に、芝浦メカトロニクスグループの新しい技術をご覧いただきたく、ご来場をお待ち申し上げます。

敬 具

— 記 —

日 時 : 2023年12月13日(水)～15日(金) 10:00～17:00

会 場 : 東京ビッグサイト 東展示棟・会議棟

展示ブース : ①総合ゾーン 東展示棟 Hall2 小間番号 2618

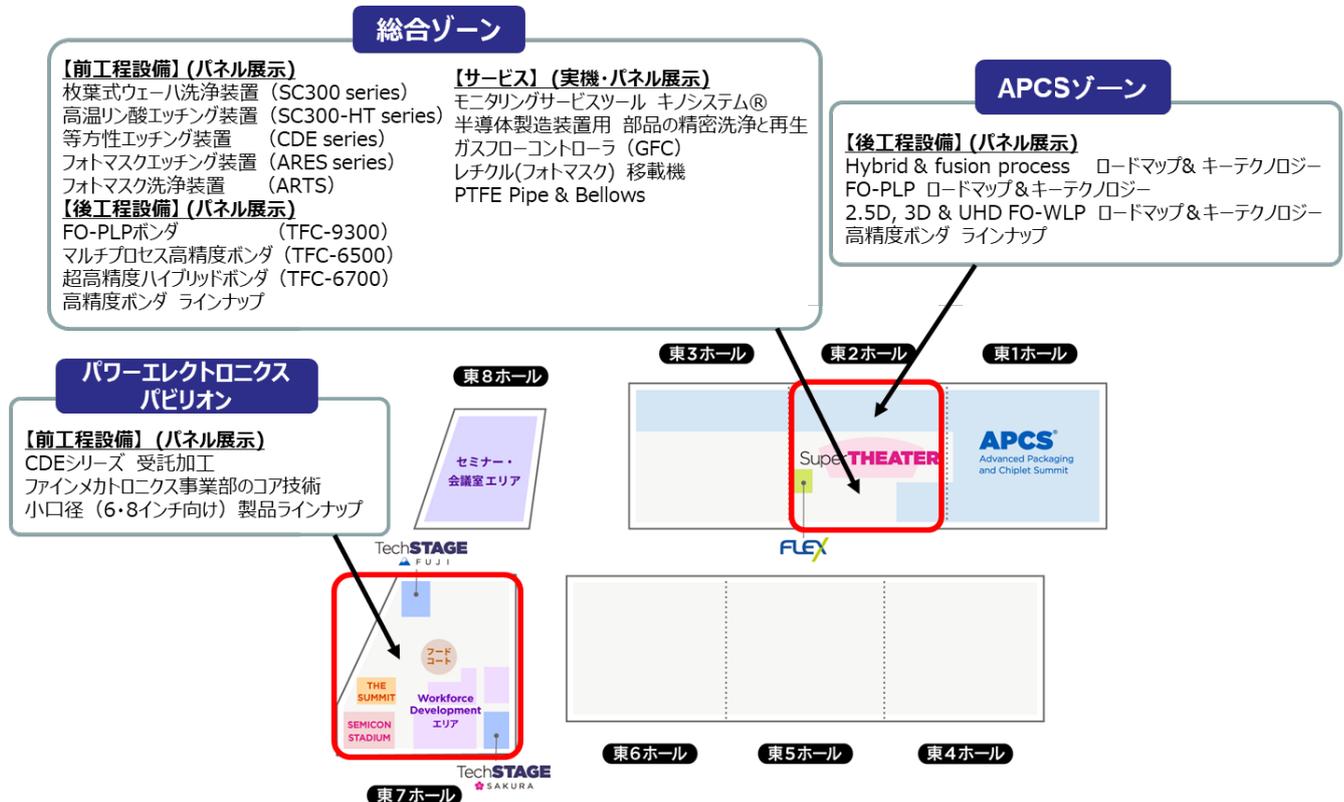
②APCSゾーン 東展示棟 Hall2 小間番号 2348

③パワーエレクトロニクスパビリオン 東展示棟 Hall7 小間番号 7331

Web サイト : <https://www.semiconjapan.org/jp/>

出展品目 :

SEMICON® JAPAN
APCS Advanced Packaging
and Chiplet Summit



以上

【ご注意】

ご来場の際は、**展示会 Web サイト**から**事前登録**していただきますようお願いいたします。

【お問い合わせ先】

芝浦エレクトック株式会社 経営企画部 企画担当

e-mail : esc@shibaura.co.jp

web サイト : <https://www.shibaura.co.jp/eletec/>

